

產品說明書

WS3500型覆晶製程助焊劑

特點

- 可溶于水
- 不含鹵化物
- 適於噴霧或浸漬
- 適於錫鉛、無鉛和高鉛合金的焊接
- 對錫球凸塊下的金屬化表面無侵蝕作用

簡介

WS-3500型倒裝片助焊劑是一種液態助焊劑，用於細間距（小於0.5mm）倒裝片的直接貼裝。它的殘留物可以用水清洗乾淨，解決了與底部填充材料的兼容性問題。

特性

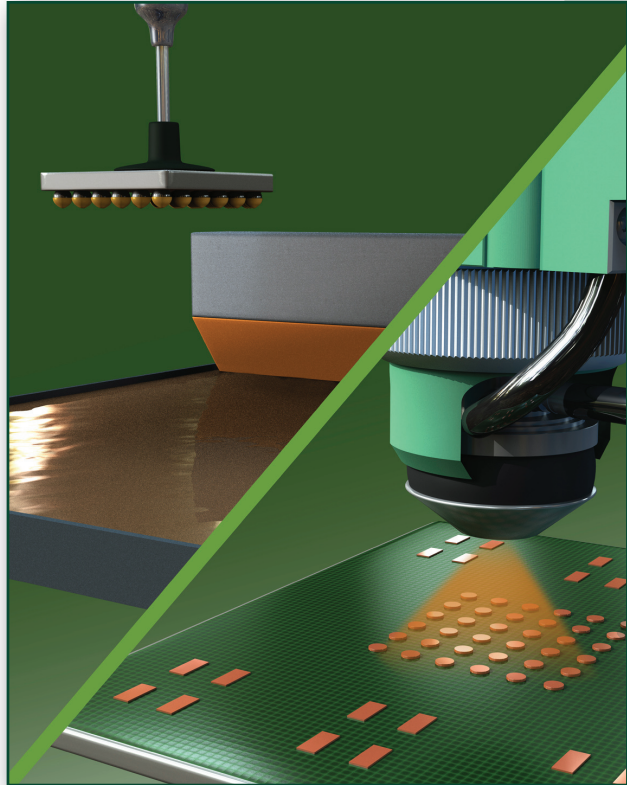
特性	測試值	測試方法
助焊劑類型	M0	J-STD-004 (IPC-TM-650)
典型粘度	60cst	Brookfield
表面絕緣電阻 (歐姆, 清洗後)	合格(在溫度為85°C、相對濕度為85%的條件下, 7天以後 $>10^9$)	IPC-B-24 2.6.3.3
色澤	介於深琥珀色和黃色之間	目視觀察
保質期	6個月(存放在-25°C到-10°C)	粘度變化或用顯微鏡檢查

所有信息僅供參考。不用作產品的規範。

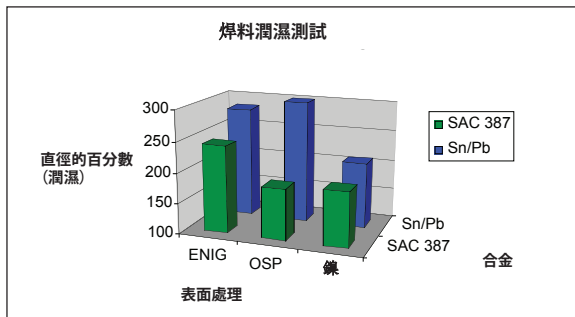
使用

推薦用量: 推薦用量為500-1500微克/平方毫米, 取決於倒裝片的種類。

對於噴霧式塗敷: 噴霧器中助焊劑儲存罐應當貯有足夠8小時的用量。罐內剩餘的助焊劑如果存放時間過長會失效(在室溫下可在罐內存放10小時以下)。噴霧器需要經常清洗, 才能保證塗敷均勻以及助焊劑的純淨度。



焊料潤濕能力的比較



接反面→

編號 98356(TC A4) R0

www.indium.com

china@indium.com

亞洲: 新加坡: +65 6268 8678

中國: 蘇州、深圳、柳州: +86 (0)512 628 34900

歐洲: Milton Keynes, Torino: +44 (0) 1908 580400

美國: Utica, Clinton, Chicago: +1 315 853 4900



經
ISO 9001
注册

WS-3500型倒裝片助焊劑

清洗

本材料可用去離子水或者加了清洗劑的水來清洗。噴淋清洗的理想條件是：25°C (室溫) 或更高, 時間 >1分鐘, 壓力 >60psi。

包裝

100克到3.8公升 (1加侖) 罐裝。可根據具體要求提供其他規格的包裝。

儲存

WS-3500的存放溫度為零下25到零下10°C, 保質期可以達到最長。在高於25°C的環境裏存放時間不可以超過4天, 儲藏溫度不可以超過30°C。WS3500從冷藏環境移到室溫後, 在使用前應在室溫下放置至少4小時。

技術支持

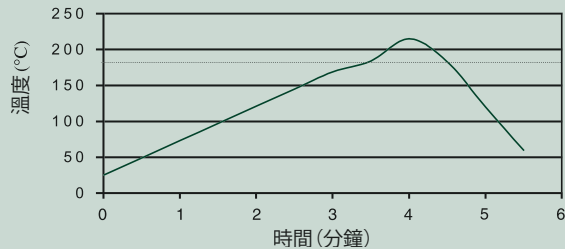
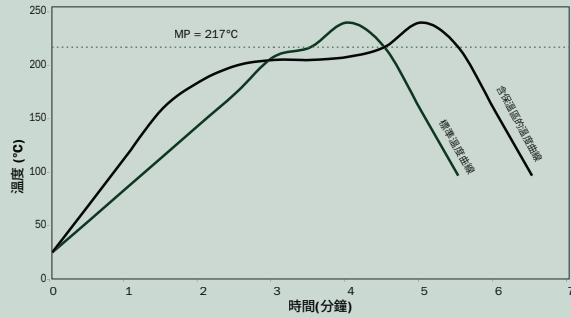
在迅速答覆全球客戶和現場技術支持方面, 錫泰公司在產業界中樹立了榜樣。錫泰公司的技術支持工程師隊伍能夠提供材料科學和半導體封裝工藝應用的各方面的專業知識。

材料安全資料

關於本產品的材料安全資料 (MSDS), 請上網查閱。
網址: <http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>。

迴焊

建議使用的溫度曲線:



在空氣或氮氣 (氧氣含量 <100ppm) 中進行迴焊時, 溫度先直線上升到比液相線溫度高 30°C, 迴焊的最高溫度應 <340°C。建議用戶從這個溫度曲線開始, 根據製程的需要對它進行優化。

此產品說明書只提供一般性資訊。不能保證或擔保這些資訊所述產品的性能, 也不可以把這些資訊看作是對所述產品的保證

或擔保。售出的產品只承諾隨產品包裝及發票所附的書面保證及有關的限制條件。

www.indium.com

china@indium.com

亞洲: 新加坡: +65 6268 8678

中國: 蘇州、深圳、柳州: +86 (0)512 628 34900

歐洲: Milton Keynes, Torino: +44 (0) 1908 580400

美國: Utica, Clinton, Chicago: +1 315 853 4900



經
ISO 9001
註冊